メック株式会社
証券コード:4971

MEXTAGE

第58期 中間 株主通信

2026年1月1日から2026年6月30日まで

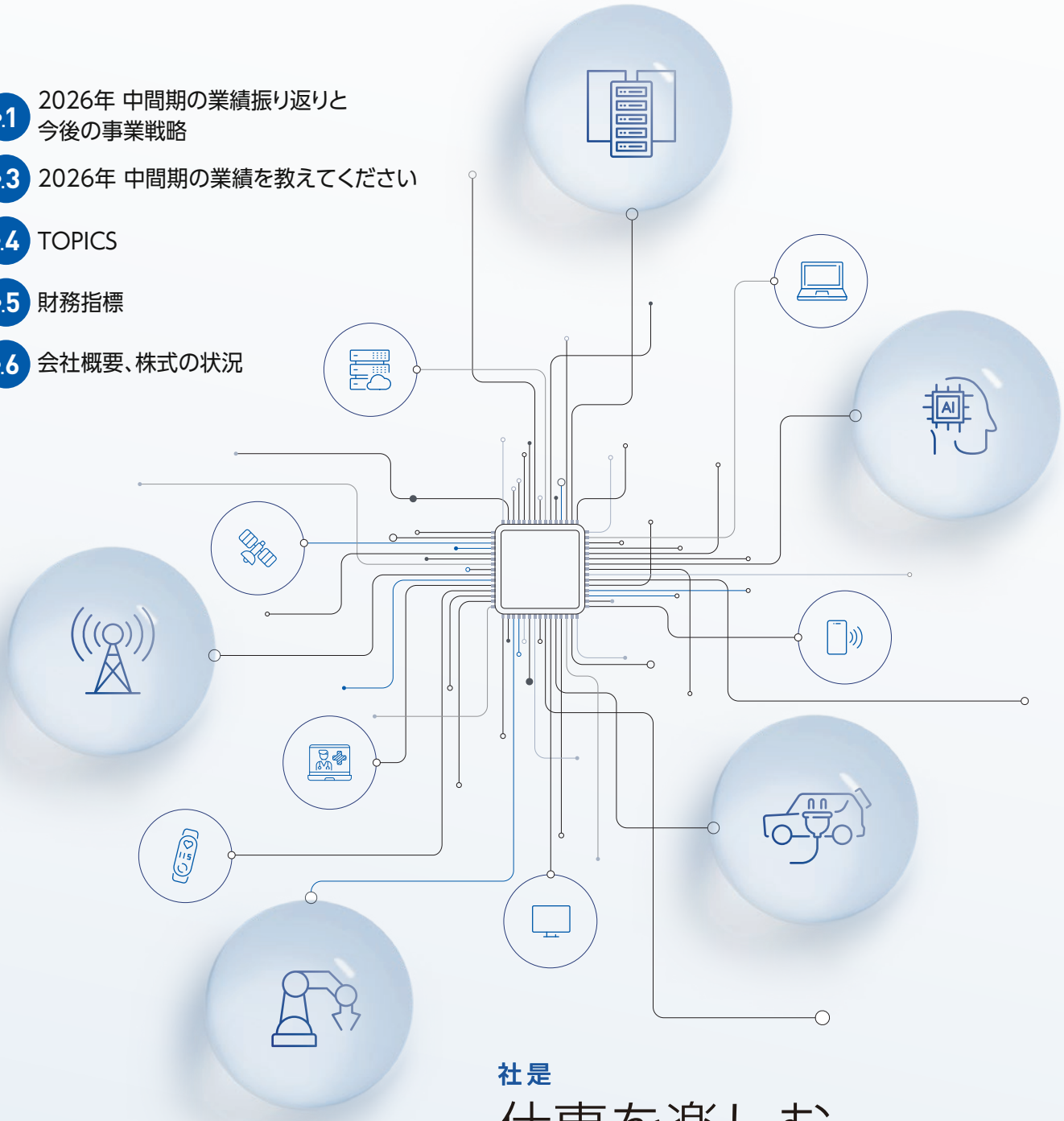
P.1 2026年 中間期の業績振り返りと今後の事業戦略

P.3 2026年 中間期の業績を教えてください

P.4 TOPICS

P.5 財務指標

P.6 会社概要、株式の状況



社是

仕事を楽しむ

経営理念

わたしたちは「独創の技術」「信頼の品質」「万全のサービス」を信条に、自由に着想し、グローバルな事業活動を通して界面価値創造を実現することで豊かで潤いのある社会と環境づくりに貢献します。

社長に聞く!

2026年 中間期の業績振り返りと
今後の事業戦略

研究開発・人財投資の強化で、次なる成長機会の獲得へ

生成AI関連の需要拡大に牽引され、大幅な増収増益に

当中間期における世界経済は、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の上昇や物価の動向、金融資本市場の変動等により先行き不透明な状況が続きましたが、わが国経済においては、雇用・所得環境の改善の動きが続く中、緩やかな回復基調で推移しました。

このような情勢のもと、半導体市場および関連するエレクトロニクス業界では、データセンターにおける生成AI関連が引き続き市場の成長を牽引しました。特にAIサーバー向けが全体を引っ張る構図は前期から変わらず、ハイパースケーラー*による投資も積極的に継続している一方、メモリーはAIサーバー向けに供給が優先される状況が続いており、パソコンやスマートフォン、車載関連には調達価格の上昇といった影響が及んでいます。

原油価格の上昇については、当社が調達する原材料は石油由来ではあるものの、原油から直接製造されるものではなく、安定的な調達を維持できていたことから、直接的な影響はほとんど受けませんでした。

これらの影響を受けて主要製品の売上動向が好調に推移し、当中間期の売上高は中間期として過去最高を計上しました。営業利益面でも、薬品出荷量の増加や収益性の高い製品需要が堅調であったことから大幅な増益となりました。

「CZシリーズ」好調持続、「APシリーズ」も進展

半導体を搭載するパッケージ基板向けに高いシェアを持つ超粗化系密着向上剤「CZシリーズ」は、生成AI関連を中心とした先端パッケージ基板向け需要の拡大を背景に、引き続き好調に推移しました。中でも主力のCZ-8101が大きく伸長し、先端用途向けのCZ-8401は母数こそまだ小さいものの、大きく増加しました。化学密着向上剤「APシリーズ」も、AI関連を中心に着実な進展が見られました。

「V-Bond・EXEシリーズ」増加、「SFシリーズ」減少

多層電子基板向け密着向上剤「V-Bondシリーズ」は、スマートフォンや車載向けは低調でしたが、衛星通信関連基板向けなどを中心に増加しました。エッチング剤「EXEシリーズ」はディスプレイ搭載のチップオンフィルム(COF)用途やCOF用途以外での微細配線形成の需要動向により増加しました。ディスプレイ向け選択エッチング剤「SFシリーズ」は、関連する電子機器の生産動向を受けて減少しました。

代表取締役社長

前田和夫

供給基盤の強化と投資計画

AIサーバー向け需要は現在、旺盛に推移していますが、サプライチェーン全体では基板の絶縁層に用いられるガラスクロス*などの部材の供給が十分に追いつかず、需要の高まりが供給増へつながりにくい局面も見られました。当社としては、必要な製品を安定的に供給できる体制を維持しつつ、こうした制約が解消されることを見越して、十分な供給体制を整えておくことが重要と考えております。

以前からお伝えしている通り、当社は福岡県北九州市に新工場を建設中であり、本年12月の稼働開始に向けて今後の成長市場に対応する供給基盤の整備を進めています。中期経営計画 Phase2における設備投資約80億円のうち約50%をこの新工場に充て、残りは研究開発の設備投資や既存工場の設備増強などに投じてまいります。あわせて人財投資にも注力するとともに、研究開発に関する投資をあらためて強化していく方針です。

事業戦略と研究開発の方向性

当社の薬品は、お客様である基板メーカーの製造プロセスでお使いいただいて初めて、その性能が形となり、世の中のお役に立つことができます。それゆえ、お客様のニーズを的確に把握し応えながら、当社の価値をご理解いただき、実際の量産工程で採用いただくことに何よりも重きを置いています。

研究開発面では、低消費電力化、エネルギー効率の向上、資源効率の改善といった方向性を重視しています。加えて、2027年頃から本格化が期待される有機インターポーザー*向け製品のスペックイン活動を進めるなど、次世代実装分野への取り組みも強化しております。今後も、汎用性とコスト競争力を備えた製品開発を進めることで、新たな市場機会の獲得を目指してまいります。

下期見通しと配当政策

下期につきましては、AIサーバー向けの需要は引き続き旺盛に推移するものと見込まれますが、前述の部材の供給状況を踏まえると、当社の出荷数量も緩やかな増加が続くものと見ております。こうした制約が解消される2027年以降には、あらためて一段の需要拡大が期待できると考えております。

配当につきましては、連結配当性向35%以上かつ、DOE（株主資本配当率）4%以上とする方針のもと、業績動向や今後の成長投資とのバランスを勘案しながら、株主の皆様への還元充実に努めてまいります。

株主の皆様へのメッセージ

当中間期の業績は、当社が長年にわたり積み重ねてきた技術開発と、世界のお客様と築き上げてきた信頼関係が実を結んだものと受け止めております。同時にそれは、10年後、15年後に同じ実りを得るための種を、今この時点でまいておかなければならないということでもあります。そのために、生産能力の拡充にとどまらず、研究開発への投資をしっかりと行い、今後の技術動向を先読みしながら、より良い製品をお届けしてまいります。

皆様のご期待に応えられるよう努めてまいりますので、引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

用語解説

■ ハイパースケーラー
大規模なデータセンターやクラウドサービスを展開し、膨大な計算資源を保有・運用する巨大IT企業群

■ ガラスクロス
電子基板材料に用いられるガラス繊維の織物で、樹脂と組み合わせることで基板の強度や寸法安定性を高める材料

■ インターポーザー
半導体チップや電子部品を接続するための中間基板。高密度配線や異種チップ間の高信頼接続を実現する重要な役割を担う

詳細はホームページ掲載の決算短信をご覧ください。
www.mec-co.com/ir/library/

2026年 中間期のポイント

押さえておきたい2026年 中間期のポイントを3ポイントにまとめています。

1. 生成AI関連向け需要の拡大で大幅な増収増益に
2. 「CZシリーズ」が引き続き好調
3. 北九州工場の稼働準備進む

2026年 中間期の実績と通期業績予想

	2025年12月期 中間期 2025年1月1日～2025年6月30日	2026年12月期 中間期 2026年1月1日～2026年6月30日	増減	2026年12月期 通期業績予想 2026年1月1日～2026年12月31日
売上高（百万円）	9,387	12,594	34.2%増	25,800
営業利益（百万円）	2,440	4,135	69.4%増	8,300
経常利益（百万円）	2,493	4,305	72.6%増	8,500
親会社株主に帰属する純利益（百万円）	1,893	3,039	60.5%増	6,000
1株当たり純利益（円）	101.47	166.43		328.58

当社の主要薬品を紹介

密着向上剤

■ CZシリーズ
半導体パッケージ基板向けに、銅樹脂間の密着性を高める用途で使用される薬品
（最終製品例：AI、データセンター、パソコン、スマートフォン等）

■ V-Bondシリーズ
多層基板向けに、銅樹脂間の密着性を高める用途で使用される薬品
（最終製品例：車、スマートフォン、衛星通信等）

エッチング剤

■ EXEシリーズ
不要な銅を溶かし微細配線を形成する用途で使用される薬品
（最終製品例：テレビ、パソコンのディスプレイ等）

■ SFシリーズ
銅を選択的に溶かす用途で使用される薬品
（最終製品例：タブレットPC等）

Q 教えて！

2026年 中間期の業績を教えてください

業績推移および製品別・セグメント別販売動向について

Q 当中間期の事業環境と業績について教えてください

A 生成AI関連がけん引し、薬品売上高は中間期として過去最高を更新

当社グループの関係市場である電子基板・部品業界は、生成AI関連の先端半導体パッケージ基板やメモリー向けの需要が旺盛で堅調に推移しました。

このような環境のもと、当社グループは2030年ビジョンの実現に向けた第二期である「Phase2 中期経営計画（2025年度～2027年度）」を達成するため、「創造と変革」を指針に事業活動に取り組みました。特に、デジタル化やグリーン化に向けて社会が変化・変革期にある中、高密度電子基板向け製品の開発、販売に注力いたしました。

主要製品の売上動向としましては、半導体を搭載するパッケージ基板向けに高いシェアを持つ超粗化系密着向上剤「CZシリーズ」は、主に生成AI関連など先端半導体パッケージ基板やメモリー向け半導体パッケージ基板に係る需要により好調な結果となりました。多層基板向け密着向上剤「V-Bondシリーズ」、微細配線形成を可能にする「EXEシリーズ」は増加し、「SFシリーズ」は関連する製品の需要動向を受け減少しました。

その結果、当中間期の売上高は125億94百万円（前年同期比34.2%増）、営業利益は、41億35百万円（同69.4%増）、売上高営業利益率は32.8%（同6.8ポイント増）、経常利益は43億5百万円（同72.6%増）、親会社株主に帰属する中間純利益は、30億39百万円（同60.5%増）となりました。

Q 製品別の販売状況を教えてください

A 「CZシリーズ」が好調に推移

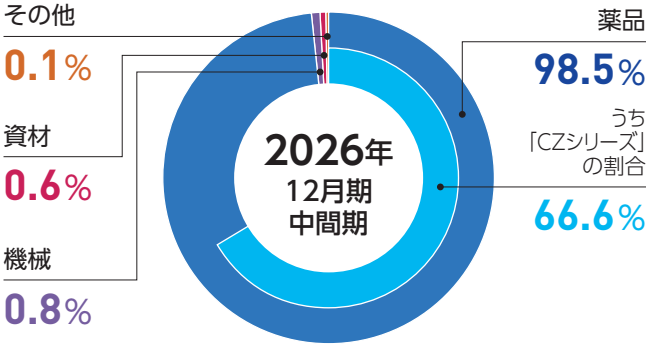
「CZシリーズ」の売上高は82億58百万円（前年同期比37.1%増）、薬品売上高に占める割合は66.6%（同0.1ポイント減）となりました。「EXEシリーズ」は9億7百万円（同44.8%増）、「V-Bondシリーズ」は4億66百万円（同16.3%増）、「SFシリーズ」は2億6百万円（同6.4%減）でした。

Q 地域別の販売動向はどうでしたか?

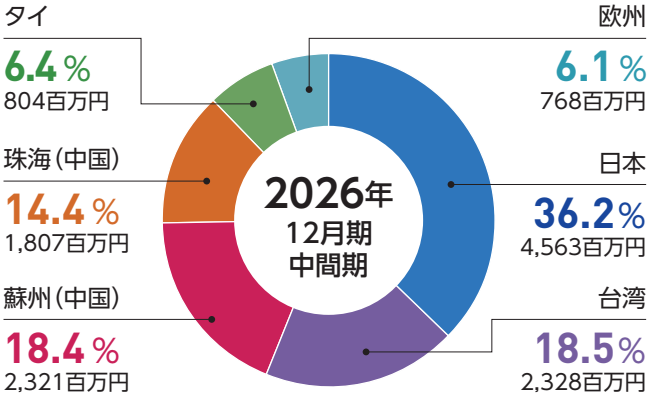
A 欧州を除く全地域で増収

地域別売上高（連結）における海外売上高比率は66.0%（前年同期比0.4ポイント減）となりました。日本では、生成AI関連など先端半導体パッケージ基板向け製品の需要が拡大基調で推移し、日本代理店経由で販売している韓国向けにおいては、メモリー向け半導体パッケージ基板の生産動向を受け堅調に推移した結果、売上高は前年同期比で増加しました。台湾では、生成AI関連などの先端半導体パッケージ基板向け需要がけん引し、売上高は前年同期比で増加しました。珠海（中国）では、メモリー向け半導体パッケージ基板に関連する製品の需要により、売上高は前年同期比で増加し、蘇州（中国）では、生成AI関連やデータセンター向け半導体パッケージ基板、ディスプレイ向けの製品の需要により、売上高は前年同期比で増加しました。一方、欧州では、汎用基板向け製品の需要は増加したものの、前年同期に発生した資材の一時的需要の反動により、売上高は前年同期比で減少しました。タイでは、電子基板メーカーの東南アジアにおける設備投資や立上げが進む中、衛星通信に関連する製品や半導体パッケージ基板向けの需要により、売上高は前年同期比で増加しました。

売上高に占める品目別割合 (%)



地域セグメント別売上高比率 (%) ／売上高 (百万円)



＊比率は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

TOPICS

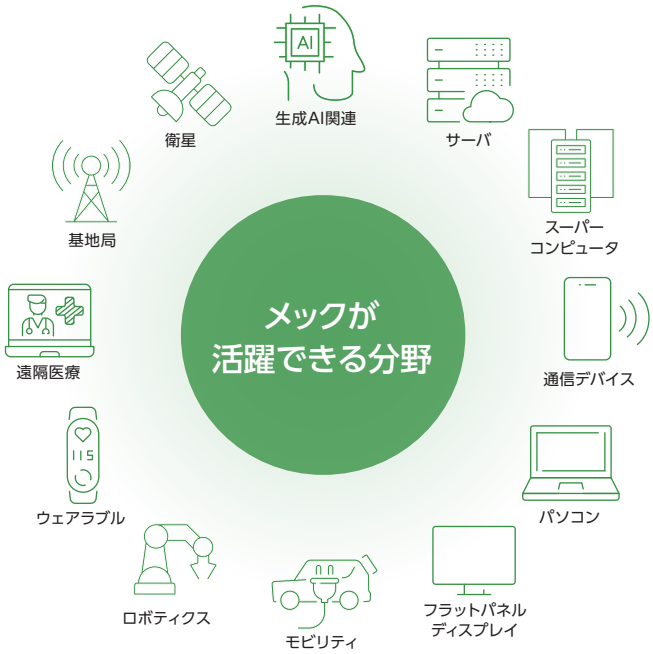
第58期 中間期（2026年1月1日～2026年6月30日）における
当社グループの主なトピックスをご紹介します。

生成AI需要の拡大による関連製品の売上増加

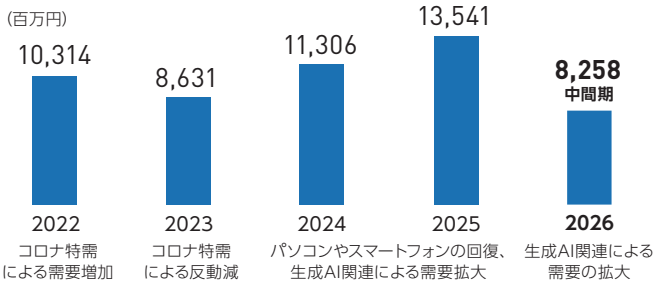
生成AI需要の拡大を背景に、先端半導体パッケージ基板向けを中心に、主力製品「CZシリーズ」の需要が堅調に伸長しています。半導体パッケージ基板の大型化・高多層化・高機能化が進む中、CZシリーズが使用される面積の拡大も需要増加を後押ししています。

引き続き、高付加価値製品の拡充を通じて、お客様のニーズに応えるとともに、半導体産業の持続的な発展に貢献してまいります。

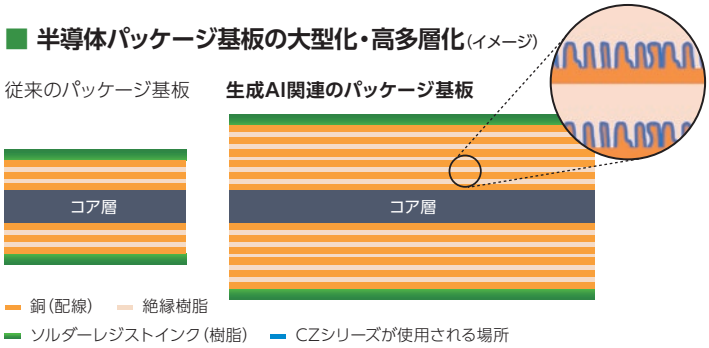
■ 使用されている最終製品例



■ CZ シリーズ売上高



■ 半導体パッケージ基板の大型化・高多層化(イメージ)



CZシリーズは銅と樹脂の密着力を向上させる目的で使用されています。

施設見学会のご案内　2026年12月3日(木)開催

株主さまに当社へのご理解をより深めていただくことを目的に、下記概要のとおり、当社本社・尼崎事業所の見学会を開催いたします。当日は会社説明を行った後、メックの“ものづくりの現場”をご見学いただきます。

見学会への参加をご希望の株主さまは、同封の応募はがきに必要事項をご記入の上、ご応募ください。

皆さまの安全確保のため、ご応募多数の場合は抽選となります。なお、ご当選者の発表は、ご当選のお知らせの発送（10月23日(金)発送予定）をもって代えさせていただきます。

見学会概要

開催日時：2026年12月3日（木曜日）
　　13時30分～（終了は16時30分の予定）
集合場所：メック株式会社　本社・尼崎事業所
　　兵庫県尼崎市杭瀬南新町三丁目4番1号
募集人数：30名様
対　　象：2026年6月末現在の株主名簿に記載または記録された当社株式100株（1単元）以上保有の株主様
応募締切：2026年10月16日（金曜日）当日消印有効

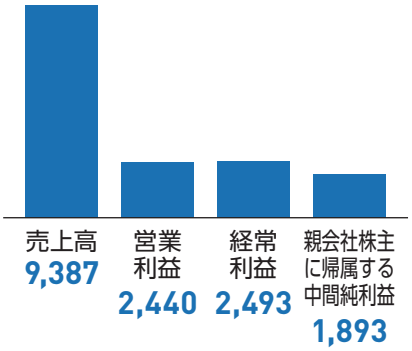
前回の様子　https://www.mec-co.com/ir/briefing/

財務指標

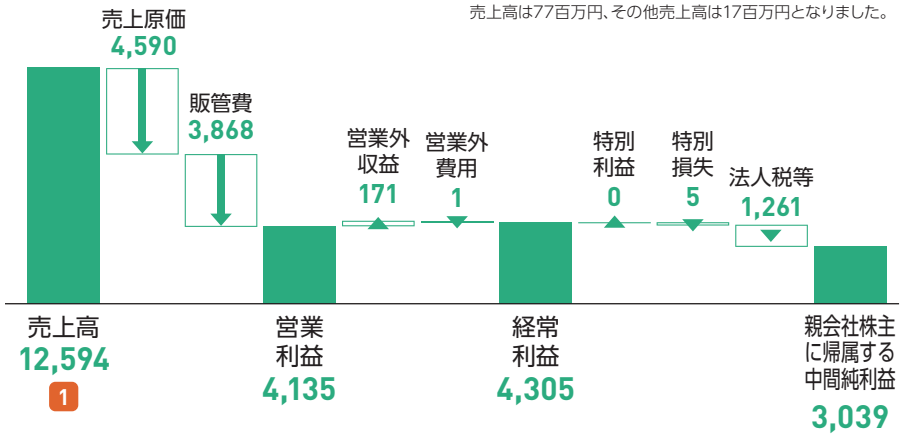
詳細はホームページ掲載の決算短信をご覧ください。
www.mec-co.com/ir/library/

連結損益計算書の概要（百万円）

2025年12月期 中間期
（2025年1月1日～2025年6月30日）



2026年12月期 中間期
（2026年1月1日～2026年6月30日）

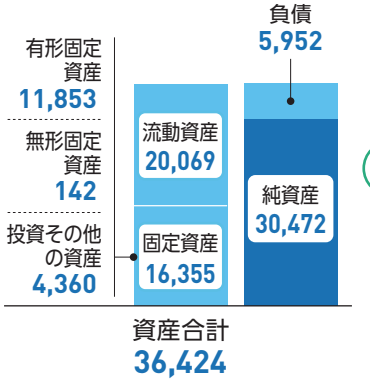


1 売上高

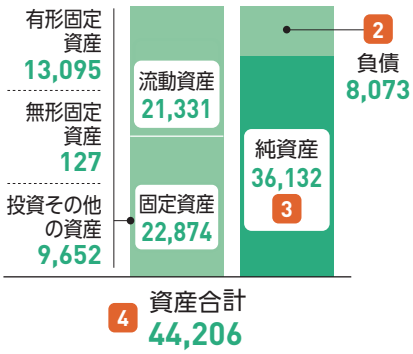
薬品売上高は124億2百万円、機械売上高は97百万円、資材売上高は77百万円、その他売上高は17百万円となりました。

連結貸借対照表の概要（百万円）

前期末
（2025年12月31日）

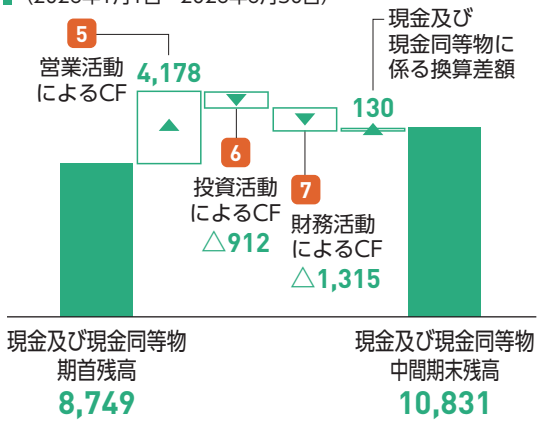


2026年12月期 中間期
（2026年6月30日）



連結キャッシュ・フロー計算書の概要（百万円）

2026年12月期 中間期
（2026年1月1日～2026年6月30日）



2 負債

負債は、長期繰延税金負債の増加等により、80億73百万円となりました。

3 純資産

純資産は、その他有価証券評価差額金の増加等により、361億32百万円となりました。

4 資産合計

資産は、保有している投資有価証券の株価の変動や北九州工場の稼働に向けた建設仮勘定の増加等により、442億6百万円となりました。

5 営業活動によるCF

営業活動の結果得られた資金は41億78百万円。これは主に税金等調整前中間純利益が43億0百万円、売上債権の減少が9億68百万円および、法人税等の支払額が14億28百万円あったこと等によるもの。

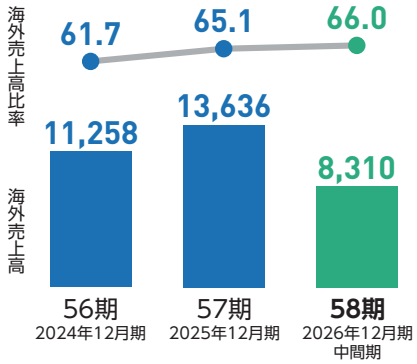
6 投資活動によるCF

投資活動の結果使用した資金は9億12百万円。これは主に有形固定資産の取得による支出が13億3百万円あったこと等によるもの。

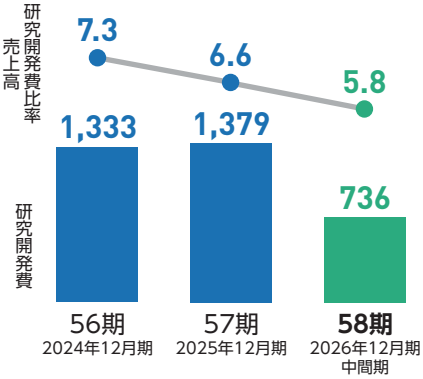
7 財務活動によるCF

財務活動の結果使用した資金は13億15百万円。これは主に配当金の支払額が13億4百万円あったこと等によるもの。

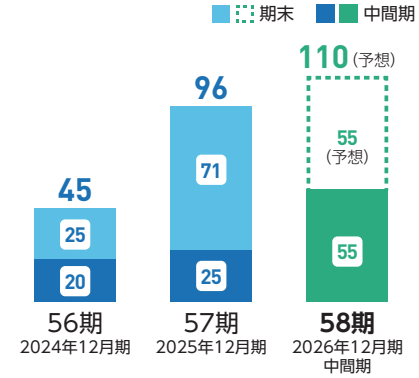
海外売上高（百万円）／比率（%）



研究開発費（百万円）／比率（%）



1株当たりの配当金（円）



会社概要 ■ 2026年6月30日現在

■ 会社概要

商号	メック株式会社
本社事務所所在地	兵庫県尼崎市杭瀬南新町三丁目４番１号
設立年月日	1969年(昭和44年)5月1日
資本金	594,142,400円
事業内容	電子基板・部品製造用薬品の開発、製造販売および機械装置、各種資材の販売

■ 取締役および執行役員

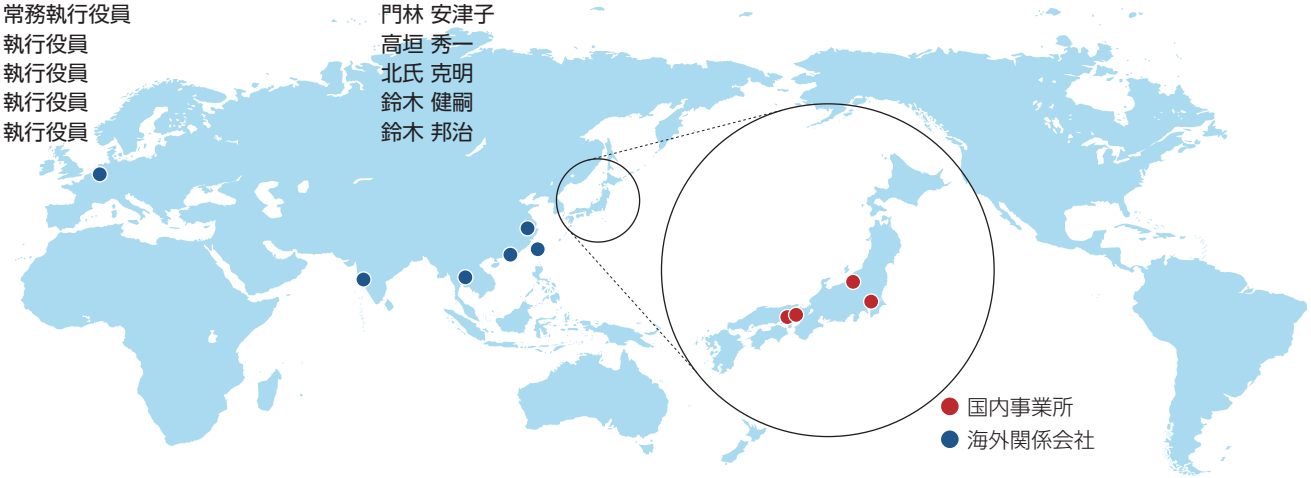
代表取締役社長	前田 和夫
取締役常務執行役員	住友 貞光
取締役常務執行役員	谷口 哲也
取締役(社外)	ルシンダ ローマン 太田
取締役 監査等委員会委員長(社外)	髙尾 光俊
取締役 監査等委員(社外)	橋本 薫
取締役 監査等委員(社外)	宮下 英二
常務執行役員	門林 安津子
執行役員	高垣 秀一
執行役員	北氏 克明
執行役員	鈴木 健嗣
執行役員	鈴木 邦治

■ 国内事業所

本社・尼崎事業所
本社・東初島事業所
東京営業所
長岡工場

■ 海外拠点

MEC TAIWAN COMPANY LTD.
MEC EUROPE NV.
MEC FINE CHEMICAL (ZHUHAI) LTD.
MEC CHINA SPECIALTY PRODUCTS (SUZHOU) CO., LTD.
MEC SPECIALTY CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.
MEC INDIA SPECIALTY CHEMICALS PRIVATE LTD.



株式の状況 ■ 2026年6月30日現在

■ 株主状況

発行済株式総数	19,571,093 株
株主数	8,667 名

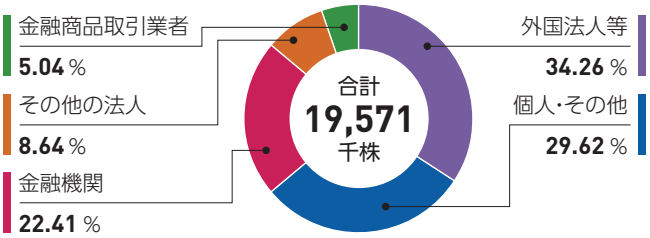
■ 大株主の状況

株主名	当社への出資状況	
	所有株数(千株)	持株比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,970	10.71
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	1,621	8.81
株式会社マエダホールディングス	1,199	6.52
前田和夫	726	3.95
メック取引先持株会	567	3.08
MORGAN STANLEY & CO. LLC	531	2.88
BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT	431	2.34
野村信託銀行株式会社(投信口)	399	2.17
モルガン・スタンレー MUFG証券株式会社	305	1.66
前田耕作	305	1.66

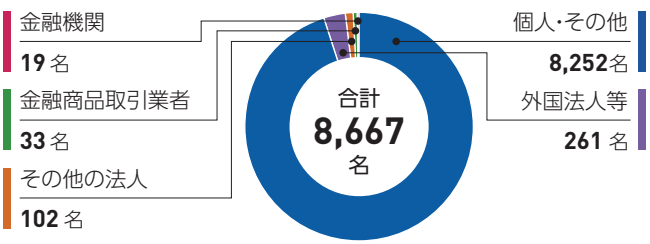
※当社は自己株式を1,182千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※持株比率は、自己株式を除く発行済株式の総数に対する比率です。

■ 株式分布状況

所有者別所有株式数



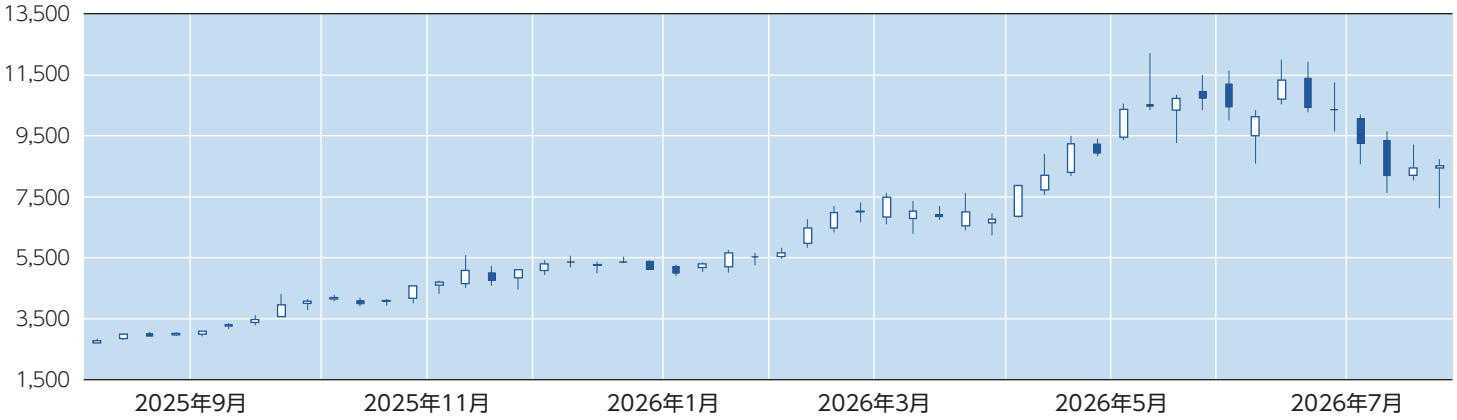
所有者別株主数



※「個人・その他」には自己株式1,182千株を含んでおります。
※比率は小数点以下第3位を切り捨てているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

株価の推移（2025年8月～2026年7月）

（単位：円）



株主メモ

事業年度	毎年1月1日から12月31日まで
期末配当金受領株主確定日	毎年12月31日
中間配当金受領株主確定日	毎年6月30日
定時株主総会	毎年3月
単元株式数	100株
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株式名簿管理人事務取扱場所	大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
郵便物送付先	三井住友信託銀行株式会社　証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話照会先※	TEL. 0120-782-031（通話料無料） 受付時間　9：00～17：00（土日休日を除く）
インターネットホームページURL	www.smtb.jp/personal/procedure/agency/
上場証券取引所	東京証券取引所プライム市場
証券コード	4971
公告の方法	電子公告により行う。 公告掲載URL　www.mec-co.com/ir/denshi/ （ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。）

株式に関する住所変更等のお手続きについてのご照会

1. 証券会社の口座をご利用の株主様は、三井住友信託銀行株式会社ではお手続きができませんので、取引証券会社へご照会ください。
2. 証券会社の口座をご利用でない株主様は、上記電話照会先※までご連絡ください。

ホームページのご紹介

当社のホームページでは企業情報、サステナビリティ情報、製品情報、投資家情報、技術情報等の各種情報を掲載しています。
サステナビリティ報告書2026を発行しました。
ぜひQRコードよりご覧ください。

株主優待情報

保有株式数	継続保有期間	優待内容
100株以上500株未満	1年以上3年未満	クオ・カード 1,000円分
	3年以上	クオ・カード 2,000円分
500株以上	1年以上3年未満	クオ・カード 2,000円分
	3年以上	クオ・カード 3,000円分

※毎年12月末日を基準日とし、当社株主名簿に記載された100株（1単元）以上保有の株主様のうち、継続して1年以上保有する方といたします。
※継続保有期間が「1年以上3年未満」とは、基準日である12月末および6月末時点の株主名簿において、同一の株主番号で3回以上連続して100株以上の保有が記載または記録されている場合をいいます。
※保有期間が「3年以上」とは、基準日である12月末および6月末時点の株主名簿において同一の株主番号で7回以上連続して100株（1単元）以上の保有が記載または記録されている場合をいいます。
※株主優待の対象となる「保有株式数」とは、「1年以上3年未満」および「3年以上」の保有期間において、基準日を含めた直近3回または7回の株主名簿に記載または記録された保有株式のうち、最も少ない株式数を指します。

ニュースメール配信サービスのご案内

当社では、ホームページにニュースリリースや新しいコンテンツが掲載された際に、ご登録者の皆様にそのタイトルとURLを電子メールにてお知らせするサービス（ニュースメール配信サービス）を行っています。
ご希望の株主様には、こちらのサービスの送信先メールアドレス（携帯電話のメールアドレス不可）を、当社ホームページまたは、RIMSNET（rims.tr.mufg.jp/）から、簡単にご登録いただけます（無料）。

アンケートのお願い

当社では、株主の皆様とのよりよいコミュニケーションを目指し、今後も業績情報の開示の充実に努めていきたいと考えています。
つきましては、この株主通信に対するご意見、ご感想をお聞かせいただきたくアンケートにご協力をお願いいたします。

※ご提供いただきました情報は、本アンケートの集計の目的以外に使用することはございません。

メック株式会社
本社／〒660-0822 兵庫県尼崎市杭瀬南新町三丁目4番1号
TEL. 06-6401-8160　FAX. 06-6401-8165
URL　www.mec-co.com/

VEGETABLE OIL INK
Waterless Printing. Naturally.
UD FONT
FSC ミックス 紙 | 責任ある森林管理を支えています FSC® C016334